

Programmable Metallization Cell 제작을 위한 Ag-doped Germanium Selenide의 고체전해질 특성

남기현, 구상모, 정홍배

광운대학교

The Solid-electrolyte Characteristics of Ag-doped Germanium Selenide for Manufacturing of Programmable Metallization Cell

Ki-Hyun Nam, Sang-Mo Koo, Hong-Bay Chung
Kwangwoon Univ.

Abstract : In this study, we studied the nature of thin films formed by photodoping chalcogenide materials with for use in programmable metallization cell devices, a type of ReRAM. We investigated the resistance of Ag-doped chalcogenide thin films varied in the applied voltage bias direction from about $1\text{ M}\Omega$ to several hundreds of Ω . As a result of these resistance change effects, it was found that these effects agreed with PMC-RAM. The results imply that a Ag-rich phase separates owing to the reaction of Ag with free atoms from the chalcogenide materials.

Key Words : PMC, solid electrolyte, chalcogenide, super-ionic

1. 서 론

PMC(Programmable Metallization Cell)의 핵심 부분이라 할 수 있는 고체전해질(solid-electrolyte)층은 비정질 chalcogenide 물질의 보다 넓은 응용가능성을 제시해 준다. 전도성이 매우 취약한 비정질 상태의 chalcogenide 박막에 금속성의 활성화 이온을 주입시키면, 전도경로가 형성되기 위한 씨앗 역할을 하는 super-ionic region이 형성된다. Chalcogenide 박막 내부에 형성된 super-ionic region은 전류를 흘려보내기도 하고, 차단하기도 하는 전해질의 역할을 수행 한다. 이처럼 PMC는 chalcogenide 박막의 전해질 특성을 이용해 전혀 다른 메모리증의 메모리 셀을 구현한다.[1-3]

비정질 chalcogenide 물질을 이용한 반도체는 상변화메모리(PRAM)에서 결실을 맺고 있다.[4] 이미 chalcogenide 박막의 비정질과 결정질 사이 상변화를 유도하여 on-state와 off-state를 형성시키는 원리의 PRAM이 상용화를 목전에 두고 있다. Chalcogenide 물질은 비단, 메모리 소자 뿐 아니라 태양전지, 박막 트랜지스터 등에 사용 될 새로운 재료로 주목받고 있으며, 특히 PMC에서 적용된 고체형태로 된 전해질 특성은 초소형화 된 고성능 2차전지로의 응용도 가능할 것으로 생각된다.

2. 실 험

2.1 PMC 메모리 소자 제작

순도 5N(99.999 %)의 Ge, Se 원소를 사용하여 $\text{Ge}_{24}\text{Se}_{76}$ 의 조성비의 비정질 벌크시료를 제작하였다. 소자의 제작은 p-type Si 기판 위에 하부 전극으로 사용할 inert

electrode(Ni, 1000 Å)를 e-beam evaporator system을 이용하여 5 Å/s 증착율로 증착한 후 sputter를 이용하여 절연층으로 사용할 SiO_2 (2000 Å)를 증착하였다. 증착 된 절연층에 패턴을 형성한 후에 Reactive Ion Etching(RIE) system을 이용하여 via hole을 형성하였다. 그 위에 고체 전해질 층으로 사용할 칼코게나이드와 Ag층은 breaking out 없이 증착하였다. chalcogenide의 두께는 1000 Å를 증착하였고, Ag는 200 Å를 증착하였다. 제작 된 sample에 광 확산 과정을 거친 후 다시 상부 전극으로 사용할 Ni를 증착하였다.

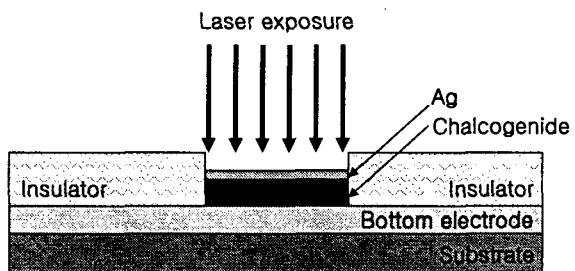


그림 1. 샘플의 광 노출과정

PMC에서는 상부 전극을 형성하기 전, 칼코게나이드와 mobile 금속 층이 형성된 후에 광 확산 과정을 거친다. 그림 1은 소자의 제작 과정 중 광 노출 단계의 단면도를 나타낸 것이다. 광 확산 과정은 Diode Pumped Solid State(DPSS, 532.0 nm, 200 mW) laser를 이용하였다.

3. 결과 및 고찰

그림 2는 $\text{Ge}_{24}\text{Se}_{76}$ 로 제작된 PMC 샘플에 의해 측정된 전류-전압 특성 그래프이다. $0 \text{ V} \rightarrow 5 \text{ V} \rightarrow 0 \text{ V} \rightarrow -5 \text{ V}$ 로 전압을 sweep 하였을 때, 변화되는 전류의 값을 나타내었다.

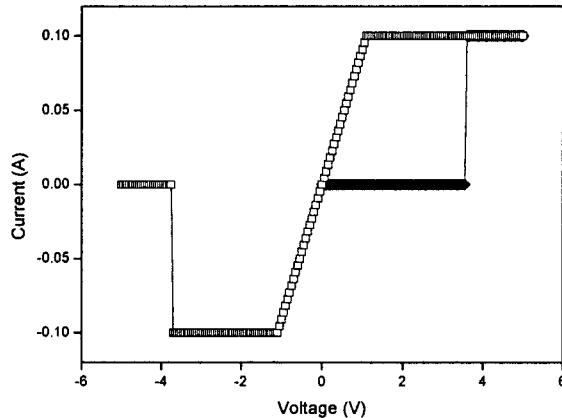


그림 2. I-V 특성 그래프

초기 전류가 흐르지 않는 상태에서 전압의 지속적인 증가는 전류의 흐름을 유도하지 못한다. 하지만, 3.6 V에서 전류가 급격히 흐르고, 전압이 증가함에 따라 전류는 계속해서 급격한 흐름을 보인다. 측정장비의 제약으로 인해 ON 상태에서의 전류값이 0.1 A로 나타나는 것을 염두에 두어야 한다. 전압이 5 V까지 증가한 후에, 감소하기 시작하면, Ohm's 법칙에 의해 전류도 서서히 감소하게 되고, -3.75 V에서 전류는 흐르지 않게 된다.

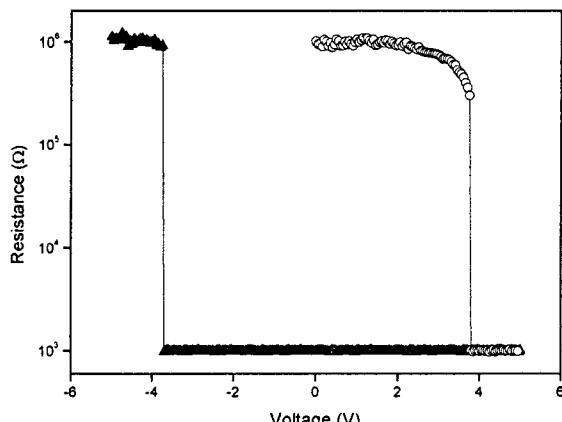


그림 3. R-V 특성 그래프

그림 3은 그림 2의 실험과 같은 방식으로 전압을 sweep 하였을 때, 변화하는 저항을 측정하여 나타낸 그래프이다. $1 \text{ M}\Omega$ 이상의 고저항 상태를 보이던 소자가 전압의 상승에 의해 약간의 저항 감소 추세를 보이고, 3.6 V의 문턱전압 이후에는 저항이 $1 \text{ K}\Omega$ 정도로 낮아지는 것을 볼 수 있다. 이후, 저항이 5 V에서 감소하여 -3.75 V에서 다시 고저항의 상태로 됨을 확인 할 수 있다.

4. 결론

우리는 이번 연구로 $\text{Ge}_{24}\text{Se}_{76}$ 의 조성비를 갖는 재료를 이용한 PMC의 특성을 확인함으로써 박막형 비정질 chalcogenide의 전해질 특성을 확인할 수 있었다.

DPSS 레이저 노출은 Ag 이온을 chalcogenide 박막 내부로 침투 시키고, Ag 이온들은 비정질 chalcogenide 박막 내부에 무수히 많이 존재하는 결함과 작용하게 된다. 적절한 순바이어스와 역바이어스의 인가는 chalcogenide 박막 내부에 super-ionic 형태로 자리 잡은 Ag 이온들을 징검다리 삼아 음극에서 공급되는 전자와 양극에서 공급되는 Ag 양이온이 결합하여 전도경로를 형성시키게 되고, 전류의 흐름을 제어한다. 이와 같은 특징은 고체형태의 비정질 chalcogenide 물질이 전해질 역할을 충분히 수행 해 내는 것을 입증하는 것이다.

감사의 글

This research was supported by the MKE (Ministry of Knowledge Economy), Korea under the ITRC (Information Technology Research Center) Support program supervised by the IITA (Institute of Information Technology Advancement) (IITA-2008-C1090-0801-0018).

참고 문헌

- [1] R. Symanczyk, et. al, "Electrical characterization of solid state ionic memory elements", Non-volatile Memory Technical Symposium, Oct, 2003.
- [2] M. Mitkova, M.N. Kozicki, "Silver incorporation in Ge-Se glasses used in programmable metallization cell devices", Journal of Non-Crystalline Solids 299-302, p. 1023-1027, 2002
- [3] M.N. Kozicki, M. Balakrishnan, C. Gopalan, C. Ratnakumar, and M. Mitkova, "Programmable Metallization Cell Memory Based on Ag-Ge-S and Cu-Ge-S Solid Electrolytes", Non-Volatile Memory Technology Symposium, p. 83-89, 2005
- [4] R. Neale, "Amorphous nonvolatile memory: the past and the future", Electronic Engineering, pp.67-78, April 2001